

## 天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2021年3月22日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于为子公司申请融资业务提供担保的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司申请融资业务提供担保的公告》。

表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年3月22日